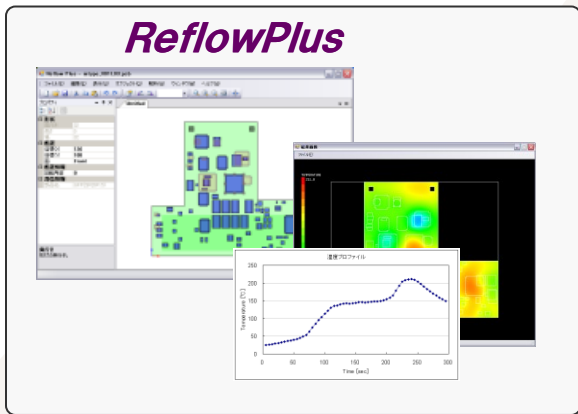


第39回 インターネブコン・ジャパンに出展します 当社ブースにぜひお立ち寄りください

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社では広く皆様に製品のご案内を申し上げるべく、エレクトロニクス製造・実装に関するアジア最大の専門技術展「インターネブコン・ジャパン」(2010年1月20日(水)~22日(金)、会場:東京ビッグサイト)に出展する運びとなりました。当社ブースでは「リフロー炉伝熱解析システム ReflowPlus」及び「基板反り・振動解析ソリューション」の展示をいたします。

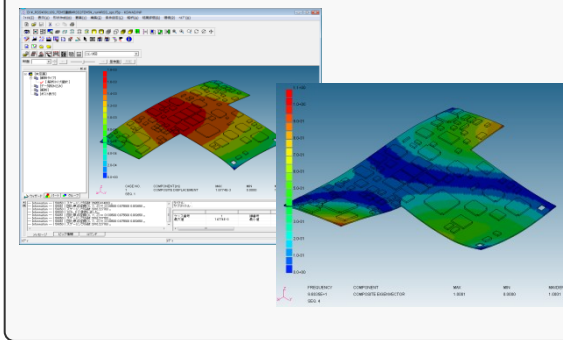


◆ 炉内の基板温度を予測する専用 シミュレーション

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、是非とも当社ブースにお立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。なお、当日は招待券を必ずお持ちください。お持ちいただかない場合は有料(¥5,000)となりますのでご注意ください。

NEW

基板反り・振動解析



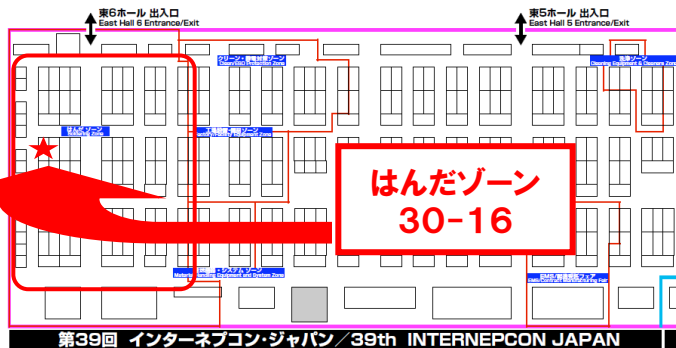
◆ プリント基板の反り・振動等の シミュレーション

敬具

株式会社富士通長野システムエンジニアリング
解析シミュレーション部 部長 大原敏靖

URL: <http://jp.fujitsu.com/group/fns/> TEL: 026-234-1991

※追加の招待券が必要な場合やご不明な点がございましたら当社までご連絡ください。至急送付させていただきます。(担当:村岡)



第39回 インターネブコン・ジャパン

エレクトロニクス製造・実装技術展

会期: 2010年1月20日[水]~22日[金]
会場: 東京ビッグサイト

弊社ブース **30-16** にお立ち寄りください

担当者が当社ブースでお待ちしております。当日は技術打合せ、見積り相談ができる技術スタッフが優先的に対応させていただきますので、個別のご相談等がございましたら事前に下記連絡先までご連絡お願い致します。

◆ お問い合わせ連絡先 ◆

(株)富士通長野システムエンジニアリング

解析シミュレーション部 担当:村岡、山浦

TEL: 026-234-1991